

エレクトロニクス実装・車載における 接合界面の劣化挙動と寿命予測・信頼性評価

1名分料金で
2人目無料セミナーURLはこちら→ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/260882>

- ◆日時：2026年08月06日（木）13:00～16:00
- ◆形式：ZoomによるWEB配信
- ◆聴講料：1名につき49,500円（税込、資料付）

会員（案内）登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円（税込）から
 ・1名で申込の場合、**46,200円（税込）**へ割引になります。
 ・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、**計49,500円（2人目無料）**です

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師：群馬大学 大学院理工学府物質・環境類材料科学プログラム 教授 博士(工学) 荳司 郁夫 氏

【受講対象・レベル】

・関連業務にたずさわって1～3年の若手技術者や新人～中堅の方、異動などにより新たに関連業務を担当することになった方

【習得できる知識】

- ・電子実装はんだ接合部の熱疲労評価手法
- ・電子実装接合部の劣化挙動評価方法
- ・先端接合材料の評価手法
- ・はんだによる接合メカニズムの基礎

【講演の趣旨】

AI、高速通信、自動運転などの急速な発展に伴い、膨大なデータを省電力で高速に処理できる次世代半導体への期待が高まっています。また、電力を供給・制御するパワー半導体は、電力損失を低減し、電子機器の省エネルギー化を実現するデバイスであり、SiCやGaNなどの次世代パワー半導体の適用が進んでいます。いずれの半導体においても、それらの能力を最大限に発揮するためには、実装材料の高信頼性が重要です。

本セミナーでは、先端電子実装用材料の接合部を対象として、その信頼性評価手法を講義します。また、関連技術の研究開発を実施するにあたり必要となるはんだ接合に関する物理現象の基礎についても講義します。

【プログラム】

1. エレクトロニクス実装の概要
 - 1-1 エレクトロニクス実装の歴史と展望
 - 1-2 エレクトロニクス実装の階層
 - 1-3 エレクトロニクス実装で用いられる接合プロセス
2. エレクトロニクス実装部の接合信頼性評価のための金属学の基礎
 - 2-1 合金状態図
 - 2-2 むれ
 - 2-3 溶解
 - 2-4 拡散
 - 2-5 回復と再結晶
3. パワー半導体および先進半導体用はんだ接合部の信頼性評価法
 - 3-1 信頼性因子と評価式
 - 3-2 加速試験による信頼性評価
 - 3-3 コフィン・マンソンの修正式を用いた熱疲労寿命評価
 - 3-4 有限要素解析による接合部の応力ひずみ解析
4. 評価事例
 - 4-1 各種鉛フリーはんだの疲労特性
 - 4-2 WL-CSPはんだ接合部の熱疲労寿命評価

『接合界面劣化・信頼』セミナー申込書

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録（無料） ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>